



技术要求:

1. 材质: 磷铜C5191 T=0.15±0.02, 电镀银底50U"min, 锡120U"min。
2. 盐雾: 先电镀后冲压工艺8H; 先冲压后电镀工艺48H。
3. 外观: 无压伤、模痕、变形、缺料、裂纹、无金属丝等不良现象。
4. 实配: 首检、巡检时使用配套胶壳进行实配, 单PIN端子卡点前端, 应可轻松插入每个基座槽位, 拉拔力符合技术要求。
5. 包装: 纸盘卷装 20000PCS/盘
6. 未注明公差: ±0.2mm

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

B		尾部往前移动0.2mm		Z Y C	21.12.03	浙江富港电子有限公司	
A		新版发行		D L P	21.09.17	1.25端子	
设计	D L P	日期	21.12.03	标准化		图样标记	重量比例
校对	L P J	日期	21.12.03	审定			
工艺		日期					
审核	L G	日期	21.12.03			共 页	第 页
1.25CB-T							